

权利要求书

1、一种封装基板，应用于芯片封装，包括：

第一导电层，位于基底的顶部，包括电源线以及信号线，所述电源线用于为芯片供电，所述信号线用于为所述芯片提供信号；

第二导电层，位于所述基底的底部，包括第一焊盘以及局部互连线，所述第一焊盘与所述信号线对应电连接，多个相关联的所述第一焊盘通过所述局部互连线电连接。

2、根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一焊盘与对应的所述信号线通过所述局部互连线电连接。

3、根据权利要求2所述的封装基板，其中，所述第二导电层包括走线层与焊盘层，所述局部互连线位于所述走线层，所述第一焊盘位于所述焊盘层，所述焊盘层形成于所述走线层上，所述局部互连线的未被所述第一焊盘覆盖的部分具有弯折角，所述弯折角为钝角。

4、根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一导电层还包括第一焊点以及第二焊点，所述第一焊点以及所述第二焊点均用于与所述芯片电连接，所述信号线连接所述第一焊点，所述电源线连接所述第二焊点。

5、根据权利要求4所述的封装基板，其中，同一所述电源线连接多个所述第二焊点。

6、根据权利要求5所述的封装基板，其中，所述电源线包括线本体以及连接部，所述连接部连接所述线本体与所述第二焊点。

7、根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述封装基板还包括第三导电层以及第一导电插塞，所述第三导电层位于所述第一导电层与所述第二导电层之间，且包括第一连接线，所述第一连接线通过第一导电插塞分别与所述信号线以及所述第一焊盘电连接。

8、根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第二导电层还包括第二焊盘，所述第二焊盘与所述电源线对应电连接。

9、根据权利要求8所述的封装基板，其中，所述封装基板还包括第二导

电插塞，所述第二焊盘与所述电源线通过所述第二导电插塞电连接。

10、根据权利要求 9 所述的封装基板，其中，所述封装基板还包括第三导电层，所述第三导电层位于所述第一导电层与所述第二导电层之间，且包括第二连接线，所述第二连接线通过第二导电插塞分别与所述电源线以及所述第二焊盘电连接。

11、根据权利要求 9 所述的封装基板，其中，同一所述电源线连接多个第二导电插塞。

12、根据权利要求 11 所述的封装基板，其中，沿所述电源线的长度方向以及宽度方向均设置多个第二导电插塞。

13、根据权利要求 10 所述的封装基板，其中，所述第一焊盘以及所述第二焊盘在所述基底的底部阵列排布。

14、一种封装结构，包括芯片、引线以及权利要求 1 所述的封装基板，所述引线一端连接所述芯片，且另一端连接所述封装基板。

15、根据权利要求 14 所述的封装结构，其中，所述芯片的数量为多个，多个所述芯片堆叠设置，所述封装结构还包括胶粘膜层，所述胶粘膜层连接相邻两个所述芯片以及所述封装基板与所述芯片。

16、根据权利要求 15 所述的封装结构，其中，多个所述芯片交错堆叠，相邻两个所述芯片分别在相对的两侧通过所述引线与所述封装基板电连接。

17、根据权利要求 14 所述的封装结构，其中，所述封装结构还包括塑封层，所述塑封层覆盖所述芯片。